

HEAT SINK COMPOUND

Para acoplamiento térmico y disipación de calor

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Compuesto para incrementar la conductividad térmica y la disipación eficaz del calor de los componentes electrónicos.

2. CARACTERÍSTICAS

- Gran conductividad térmica.
- Excelente amortiguador de la humedad.
- Bajo contenido de impurezas metálicas.

3. APLICACIONES

- Placas de circuito impreso.
- Componentes electrónicos.
- Montajes de control.

4. INDICACIONES

- Aplicar sobre una superficie limpia y seca.
- No mezclar con otros productos.
- No utilizar en un equipo con corriente.

Hay disponible una ficha de datos de seguridad (SDS) de acuerdo con el Reglamento CE N.º 1907/2006 Art.31 y enmiendas para todos los productos.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Aspecto: | Pasta. |
| Color: | Blanco. |
| Olor: | Olor característico. |
| Densidad a 20 °C: | 2,3 g/cm ³ |
| Temperatura de funcionamiento: | -50 °C a 300 °C |

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 2/2

HEAT SINK COMPOUND

6. EMBALAJE

Tubo: 20G
100G

Todas las informaciones de esta publicación se basan en la experiencia del servicio y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la amplia variedad de equipos y condiciones y a los factores humanos impredecibles que intervienen, recomendamos que se prueben nuestros productos en el trabajo antes de su uso. Toda la información se ofrece de buena fe pero sin garantía ni expresa ni implícita. Es posible que esta Ficha técnica ya haya sido revisada en este momento por motivos tales como legislación, disponibilidad de componentes y experiencias adquiridas recientemente. La última y única versión válida de esta Hoja de datos técnicos le será enviada con una simple solicitud o puede encontrarla en nuestro sitio web: www.crcind.com.

Le recomendamos que se registre en este sitio web para este producto y así poder recibir automáticamente cualquier versión actualizada en el futuro.

Versión: 4.2
Fecha: 20/11/2021

